

## 第 15 回電子部品 EXPO 出展のご案内

拝啓 師走の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。この度、第 15 回電子部品 EXPO - ELE EXPO-(ネブコンジャパン内)に米国 Advanced Interconnections 社及び Memory Protection Devices 社と共同出展いたします。ご多忙中とは存じますが、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

会 期：2014 年 1 月 15 日(水)～17 日(金) 10:00～18:00 [17 日(金)のみ 17:00 終了]

会 場：東京ビッグサイト

### 共同出展社のご案内



**ADVANCED**  
INTERCONNECTIONS.

アドバンスト・インターコネクションズは電子機器用コネクタの設計、製造の代表的な会社として 1982 年の創業以来世界中で幅広く支持されております。特に IC ソケット、アダプタ、基板コネクタにおいてはその技術に高い評価を得ております。

当社の製品全てに高性能な切削機械を使った自社加工ターミナル(ピン)の多接触(マルチフィンガー)クリップが採用されており、スルーホール及び表面実装など標準仕様からお客様のご要望に合わせた様々な仕様の製品を設計し提供することが可能です。

また、数多くのインシュレーターとめっき仕様を取り揃えて RoHS を始め世界各国の様々な規格に対応してお客様からの要求にお応えします。

#### Mezza-Pede キバカン 狭ピッチ基板間コネクタ

$\mu$ -iTLA コネクタとしても使用可能な狭ピッチコネクタ。基板間コネクタと使用した場合の基板間はたった 4 ミリと薄型仕様に適しており、丸ピン+6 枚コンタクトで高い接触性を持っております。



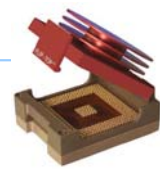
#### 高品質の自社加工ターミナル

精密に自社加工で作上げたターミナル(ピン)にはベリリウム銅製の多接触クリップが入っており、数百種類の高品質な標準仕様から、薄型用、表面実装用やリフローに便利なはんだリング付きなど各種取り揃えております。



#### Flip-Top BGA ソケット

Flip-Top ソケットは既存の基板にも簡単に実装可能な場所を取らない設計となっており、試作用の IC 評価に優れたソケットです。デバイスははんだ付けせず使用可能なため、何度でも交換が可能です。



**MPD**

MEMORY PROTECTION DEVICES, INC.

メモリープロテクションデバイス社(MPD 社)は 1980 年の創業以来、電池ホルダを始め、車載用 12V 部品、オーディオコネクタ、ヒューズホルダ、DC ジャック、プラグなど単なる電子製品のサプライヤーではなく、顧客のニーズに合わせた製品設計などにも取り組んでおります。

特に電池ホルダでは業界一番の製造ラインを世界各地に持ち、600 万以上の種類を取り揃えております。

#### コイン電池用ホルダ

$\phi$  10mm～30mm まで、表面実装、基板ピン取付仕様、簡易金属タイプのものなど幅広く取り揃えております。特に耐高温、耐振動仕様などの開発も日々手がけており毎年数多くの新商品が設計されております。



#### 円筒形電池用ホルダ

本数、配置はもとよりはんだラグ付き、基板ピン取付仕様、ワイヤー付きなど全ての種類にオプションをそろえております。また充電電池用のホルダや、マイクロソフト社と共同開発をしたプラス/マイナス端子を選ばずどちらにでも挿入が可能なホルダも高い評価を得ております。

